

FEI社製

New!!

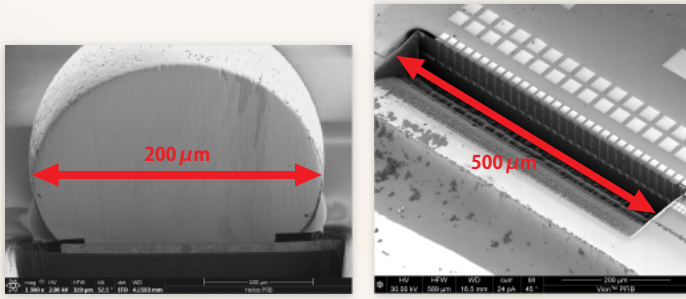
# プラズマFIB-SEM

Helios G4 PFIB

3Dパッケージの故障解析や、広い領域のFIB加工や観察など様々なニーズに対応することが可能です。



Xeを用いたプラズマFIBなので、  
大面積の加工が可能。



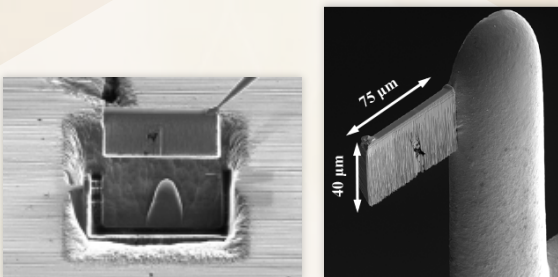
はんだバンプ加工例

TSV 加工例

プラズマ FIB なので短時間に大面積の加工が可能。

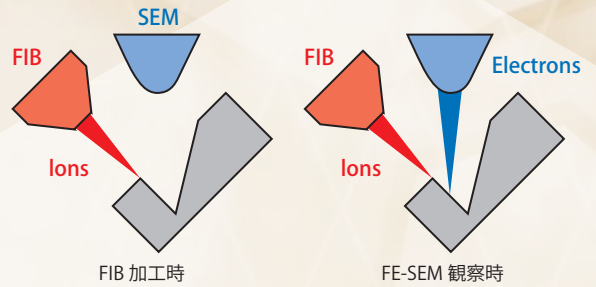
500 μm の断面加工が  
可能に。

ピックアップ機能を  
内蔵しているので、精度の高い  
STEM/TEM サンプル作製が可能。



従来の FIB では 10 μm × 20 μm 程度でしたが、  
プラズマ FIB では 40 μm × 75 μm の薄膜作製が可能です。

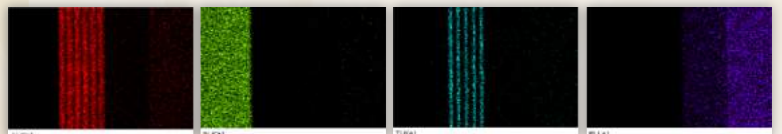
FE-SEM を搭載しているので、  
微小な不良箇所を見逃しません。



傾斜に対応したイオンビームが搭載されているため、  
観察と加工がサンプルを動かさずに実施できる。

加工しながら断面像を  
確認できる。

STEM/EDS 搭載のため、  
SEM/EDS より精度の高い分析が可能。



Ti 層 (10nm)/Al 層 (30nm) の EDS マッピング。  
10nm の薄層も明確に分析可能。